

混合内存立方联盟发布新规范 推动混合内存立方的性能和行业应用

加州圣何塞和爱达荷州博伊西，2014年11月19日（GLOBE NEWSWIRE）——混合内存立方联盟（HMCC）一直致力于开发和建立混合内存立方（HMC）的行业标准接口规范，今日宣布其 HMCC 2.0 规范（HMCC 2.0）已定稿并公开。

新的 HMCC 2.0 规范将数据传输率从 15 Gb/秒提高到 30 Gb/秒，为存储器性能建立了新的门槛。HMCC 2.0 还将相关信道模型从短距离（SR）迁移到非常短距离（VSR），以便与现有行业命名法保持一致。

“自成立以来，混合内存立方联盟已拥有 150 位成员，发展势头迅猛，因此，在如何使接口更好地符合将来的应用上获得了越来越多更好的意见，” Objective Analysis 主管 Jim Handy 说。“发布 HMCC 2.0 规范表明了对发展一系列针对所有高性能计算应用的规范的承诺。”

HMCC 成立于 2011 年 10 月，由 Altera、Micron、Open-Silicon、Samsung Electronics 和 Xilinx 合作开发。2013 年 5 月，HMCC 初次定稿并发布，表明半导体开发的领导者们达成共识，以推动 HMC 在下一代系统中的应用。自成立以来，HMCC 已逐渐吸纳了 150 多家 OEM、推动者和集成商，成员们定期参与 HMC 标准的开发和讨论。第二代 HMCC 规范的定稿是该创新存储器技术开发过程中的一个重要里程碑并预示其后续应用。

“HMCC 2.0 为设计师提供了成熟的解决方案，以突破存储器瓶颈并提供具有空前存储器性能的新一代系统，” Open-Silicon 的 IP 和工程运营副总裁 Hans Boumeester 说。“新标准得到批准意味着设计师将能获得符合标准的 IP，可立刻集成到满足下一代数据中心和高性能计算应用不断增长的带宽需求的芯片和系统中。”

关于 HMC

HMC 已被行业领导者和有影响力的人士视为一项万众期待的技术方案，它突破了传统内存技术所受限制，在提供超高系统性能的同时显著减少了每比特耗电量。当代 HMC 技术提供的带宽是 DDR3 模块的 15 倍，而耗电量比该技术降低 70% 以上，体积减小 90% 以上。HMC 的抽象存储器使设计师可将更多时间投入如何利用 HMC 的革命性功能和性能上，减少为实现基本功能而选择多个存储器参数所需时间。它还能管理纠错、恢复、刷新和因存储器过程变化而恶化的其他参数。

关于 HMCC

混合内存立方联盟由全球半导体界的领导成员建立，致力于开发和建立混合内存立方技术的行业标准接口规范。联盟成员包括 Altera Corporation、ARM、IBM、Micron Technology, Inc.、Open-Silicon, Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、SK hynix Inc. 和 Xilinx, Inc.。欲知有关 HMCC 的更多信息，请访问：www.hybridmemorycube.org。

联系方式: Karl Stetson
Zeno Group for Micron
Karl.stetson@zenogroup.com
206-297-5943